

用途：FPC 用カバーレイ等

1.概要と特徴

1-1)概要

スクリーン印刷で形成するカバーレイ用インクです。既にポリアイミド化をしてありますので、溶媒を乾燥させるだけでカバーレイを得る事が出来ます。

1-2)特徴と一般性状

一般的なカバーレイは、ベースポリアイミドフィルムに熱硬化性接着層を塗布した構造となっておりますが、本カバーレイはベースポリアイミドも熱硬化性接着層も有しませんので、柔らかく耐熱性に優れるという事が最大の特徴です。

項目	単位	性状	備考
外観	-	青	
粘度	mPas	30,000~50,000	B 型粘度計、24℃
固形分	%	29.5~34%	
溶媒	-	安息香酸メチル、トリグリム	

2.物性

項目	単位	特性値	備考
ガラス転移点	℃	90	TMA
熱膨張係数	ppm	515	TMA
熱分解温度	℃	378	Td5
弾性率	Gpa	0.75	PIRD 法
伸び率	%	130 以上	PIRD 法
耐折性	回	101	R=0.38,500g

3.使用方法

工程	使用条件
製品タイプ	1液タイプ
保管	暗所(-20~10℃)
印刷	使用する印刷機・版・スキージ等により異なります。湿度 55%以下の環境下でご使用下さい。
乾燥	120℃×60min+180℃×30min



4.お問い合わせ先

〒236-0002 神奈川県横浜市金沢区鳥浜町 12-5
株式会社ピーアイ技術研究所 横浜本社 営業部
TEL：045-778-3355
FAX：045-778-3356
E-mail：info@pird.co.jp

Q-PILON® 株式会社ピーアイ技術研究所

無限の可能性を秘めた超高耐熱樹脂
ブロック共重合ポリアイミド